FED
Wir verbinden

Call for Papers

34. FED-Konferenz
23. und 24. September 2026
Bamberg

Design und Fertigung elektronischer Baugruppen

Strategien, Lösungen und Impulse für Technik und Organisation

Leiterplatten- und Baugruppendesign

Design for Excellence in der Praxis
Leiterplattentechnologie, Basismaterial, Lagenaufbau Wärmemanagement und thermisches Design High-Speed-Design, Signal- und Power-Integrität Standards, Tools, Datenqualität und Best Practices

Digitale Transformation, KI und Sicherheit

Praktischer Einsatz von KI in Design und Fertigung
Datenmodelle, Datenverantwortung, Transparenz
Cybersicherheit in Design, Produktion und Lieferkette
Grenzen, Risiken und Lessons Learned

Baugruppenfertigung und EMS

Automatisierung und KI-Unterstützung
Digitale Prozesse und durchgängige Daten
Druck- und Lötprozesse, Inspektion und Test
Produktivität, Qualität, Wirtschaftlichkeit

Lösungen für KMU: Praxis & Organisation

Digitale Transformation im Mittelstand
Fachkräfte, Qualifizierung, Wissenstransfer
Arbeitsorganisation, Führung, Zusammenarbeit
Kosten, Time-to-Market, Make-or-Buy

Aufbau- und Verbindungstechnik

Advanced Packaging und Systemintegration
3D-Integration und 3D-Design, Best Practices
Miniaturisierung, Embedding, 3D-Elektronik
Additive Fertigungsprozesse

Strategie, Regulierung und Verantwortung

Nachhaltige Entwicklung und Fertigung
Reparatur, Lebensdauer und Recycling
Normen, Zulassungen, Compliance
CO_2-Fußabdruck und digitaler Produktpass

Wir freuen uns auf Ihren Themenvorschlag bis zum 29. März 2026.

Bitte reichen Sie die aussagekräftige Beschreibung Ihres Vortragsthemas online ein.
Die Redezeit für **werbefreie Fachvorträge** beträgt 35 Minuten; Beiträge können auf **Deutsch oder Englisch** eingereicht werden. Über die Aufnahme in das Konferenzprogramm entscheidet eine Programmkommission.

Abstract einreichen: **fed-konferenz.de/cfp**

Die FED-Konferenz: Baugruppendesign trifft Fertigung

Die **FED-Konferenz** ist die zentrale Plattform für alle, die Verantwortung für industrielle Elektronik tragen. Sie bringt Leiterplattendesigner, Leiterplatten- und Baugruppenfertiger, EMS- und OEM-Unternehmen, Zulieferer und angewandte Forschung zusammen, um tragfähige Lösungen für die Praxis zu zeigen, zu diskutieren und weiterzuentwickeln.

Über 300 Fachleute diskutieren auf Augenhöhe und bringen ihre Erfahrungen, Lösungsansätze und Einschätzungen aus der Praxis ein. Zwei Konferenztage mit Fachvorträgen, Diskussionen, Keynotes und begleitender Ausstellung geben den Teilnehmenden die Möglichkeit, konkrete Ansätze kennenzulernen, eigene Fragestellungen einzuordnen und frische Impulse für die tägliche Arbeit mitzunehmen.

Mit dem **Call for Papers** lädt der FED dazu ein, die Konferenz aktiv mitzugestalten. Gesucht sind Beiträge, die Elektronikdesign und Elektronikfertigung gemeinsam denken und konkrete Einblicke in aktuelle Herausforderungen und Lösungsansätze geben. Im Mittelpunkt stehen praxisrelevante Themen wie Design for Excellence, der praktische Einsatz von KI in Design- und Fertigungsprozessen sowie Nachhaltigkeit über den gesamten Produktlebenszyklus.

Willkommen sind Vorträge, die zeigen, was funktioniert und warum: Erfahrungsberichte aus der industriellen Praxis, bewährte Vorgehensweisen und neue Ansätze in Technik und Organisation. Entscheidend ist der Mehrwert für die Teilnehmenden: Orientierung, Übertragbarkeit und eine realistische Einordnung technischer, organisatorischer und wirtschaftlicher Zusammenhänge.

Die FED-Konferenz im Überblick

Themenvielfalt: Technologien und Prozesse für Design, Fertigung und Industrialisierung von Leiterplatte, Baugruppen und Systeme
Publikum: Entwickler, Designer, Fertigungs-spezialisten und Entscheider im direkten Austausch
Fachliche Tiefe: Fachvorträge und moderierte Expertenrunden in vier Thementracks
Praxisbezug: Begleitende Fachausstellung für den Entwicklungs- und Fertigungsalltag
Impulse & Dialog: Keynotes mit Substanz und After-Work-Event am 23. September

Der Nutzen für Sie als Redner

Relevante Reichweite: Präsentieren Sie Ihr Thema vor qualifiziertem Fachpublikum aus Industrie und angewandter Forschung.
Fachlicher Dialog: Diskutieren Sie Ihre Inhalte direkt mit Anwendern, Experten und Entscheidern.
Positionierung: Stärken Sie Ihre fachliche Reputation durch das Konferenzmarketing des FED in Fachmedien und sozialen Netzwerken.
Wertschätzung: Sie sind unser Gast am Konferenztag Ihres Vortrages und der Abendveranstaltung am 23. September in Bamberg.

Fakten, Themen und Eindrücke der FED-Konferenzen: fed-konferenz.de

Ihr Ansprechpartner

Thomas Bujotzek
Referent Technik und Elektronik im FED
Telefon +49 30 340 6030 55
E-Mail t.bujotzek@fed.de

FED
Wir verbinden

Fachverband Elektronikdesign und -fertigung e.V.